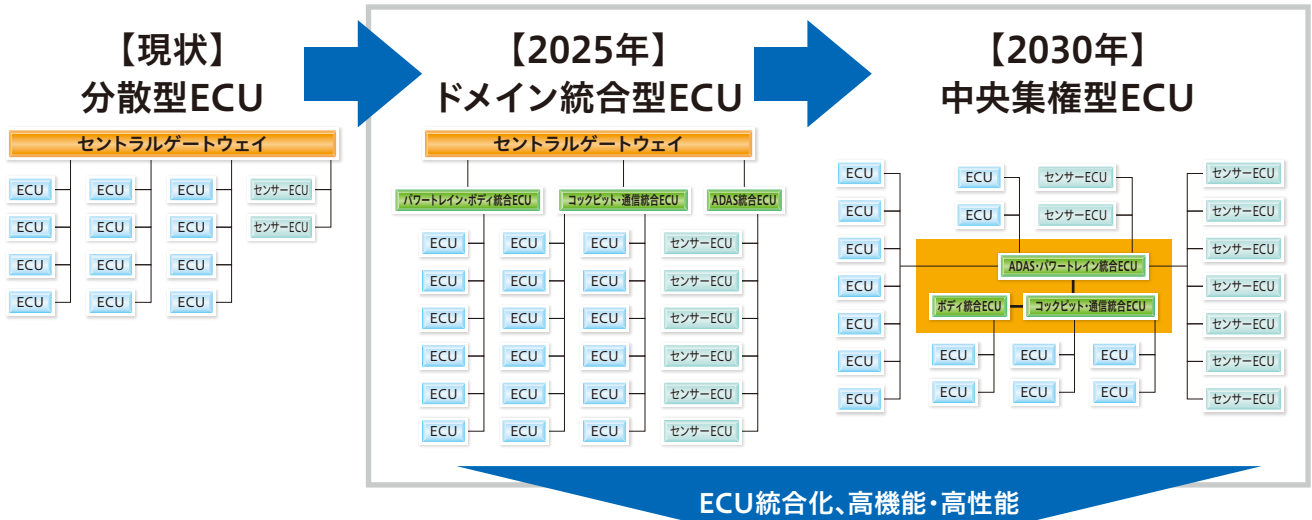


車載用途プリント配線板 技術ラインナップ

Automotive PWB Technology Lineup

プリント配線板に求められる技術



高密度・高周波

部品高機能・高性能化⇒狭ピッチ配線
高速信号通信⇒高周波対応

小型化

省スペース化
3D実装対応

放熱

部品発熱⇒プリント配線板での放熱対応

技術ロードマップ

基板技術ラインナップ	自動運転技術					電動化技術					年度					
	センサー		コンピューター	通信		パワートレイン/モーター		電子制御		チャージング	23	24	25	26	27	28
	ミリ波/LIDAR	カメラ/CMOS	ドメインPC/HPC	AIP	V2X/5G-6G	コントローラ	インバーター/コンバーター	バッテリー/マネジメント	パワーMod	DC/ACコンバーター	インバーター					
HDI基板 (LVHスタック構造)	●	●	●	●	●							4段試作	~4段量産	~5段量産		
AnyLayer構造	●	●	●	●	●							~12L量産	~14L量産			
特性インピーダンス	●	●	●	●	●							±10% 実測保証	±10% 工程保証	±10% 量産シミュレーション保証		
低誘電材料の採用	●			●	●							4段試作	~4段量産	~5段量産		
FR-4Flex構造	●					●						貫通量産	HDI試作	貫通/HDI量産		
部品内蔵構造		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	試作		量産		
銅インレイ構造						●	●	●	●	●	●		φ3、φ6量産	銅ブロック埋込試作	量産	
厚銅構造						●	●	●	●	●	●		175μ量産		量産	
メガTH構造						●	●	●	●	●	●		210μ開発	210μ試作		量産
メタルベース構造						●	●	●	●	●	●		φ0.4試作	φ0.4量産		量産
						●	●	●	●	●	●		小径化開発	小径化試作		量産
						●	●	●	●	●	●		単層量産		量産	
						●	●	●	●	●	●		複層化開発	複層化試作		量産